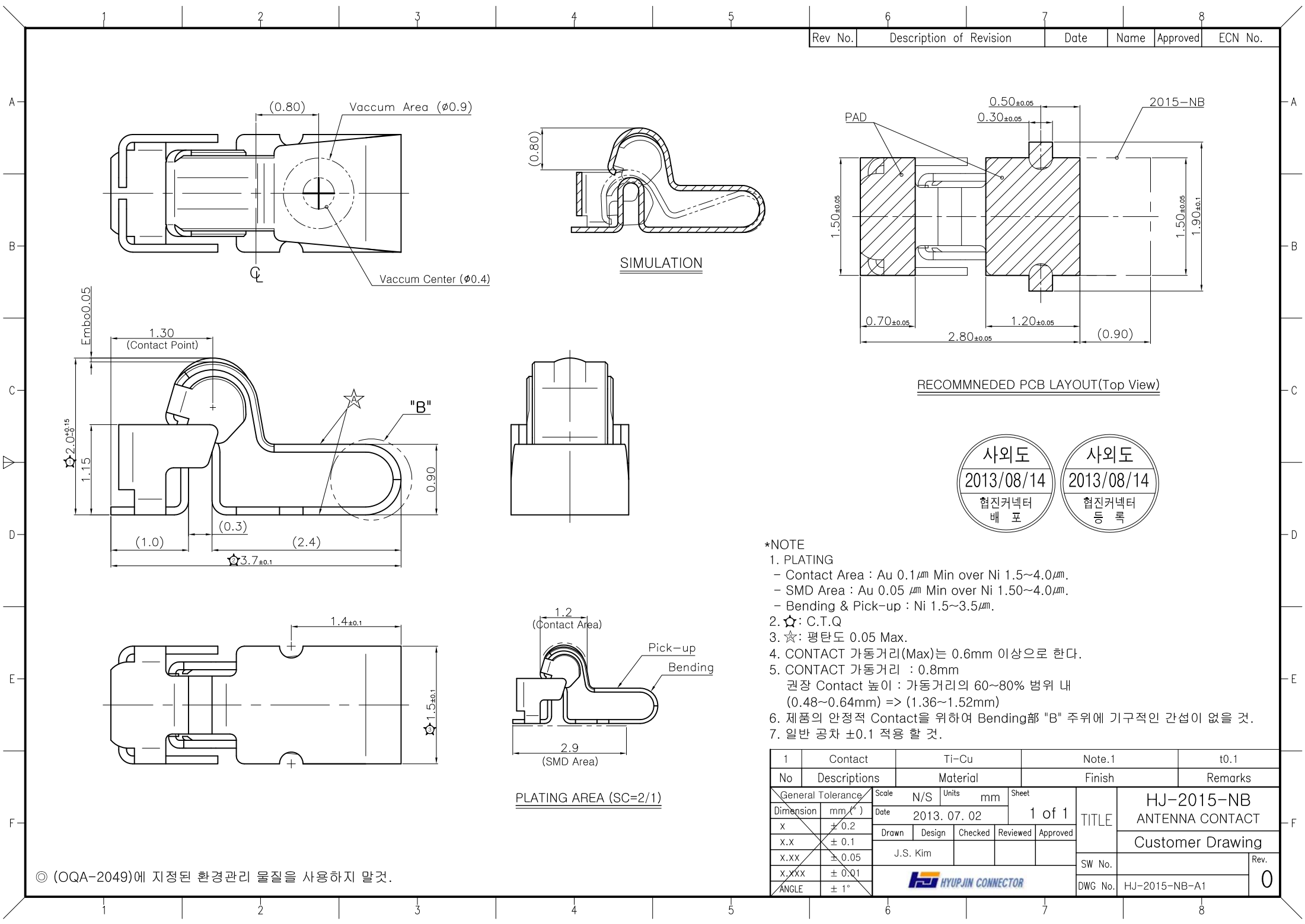


Rev No.	Description of Revision	Date	Name	Approved	ECN No.



© (OQA-2049)에 지정된 환경관리 물질을 사용하지 말것.

- *NOTE
1. PLATING
 - Contact Area : Au 0.1 μ m Min over Ni 1.5~4.0 μ m.
 - SMD Area : Au 0.05 μ m Min over Ni 1.50~4.0 μ m.
 - Bending & Pick-up : Ni 1.5~3.5 μ m.
 2. ☆: C.T.Q
 3. ☆: 평탄도 0.05 Max.
 4. CONTACT 가동거리(Max)는 0.6mm 이상으로 한다.
 5. CONTACT 가동거리 : 0.8mm
 권장 Contact 높이 : 가동거리의 60~80% 범위 내
 (0.48~0.64mm) => (1.36~1.52mm)
 6. 제품의 안정적 Contact을 위하여 Bending部 "B" 주위에 기구적인 간섭이 없을 것.
 7. 일반 공차 ± 0.1 적용 할 것.

1	Contact	Ti-Cu	Note.1	t0.1
No	Descriptions	Material	Finish	Remarks
General Tolerance		Scale	N/S	Units
Dimension		Date	2013. 07. 02	Sheet
X		1 of 1		TITLE
X.X		Drawn	Design	Checked
X.XX		J.S. Kim		Reviewed
X.XXX		HYUPJIN CONNECTOR		Approved
ANGLE		1°		SW No.
				DWG No.
				HJ-2015-NB-A1
				Rev.
				0